

## 마이크론, 차세대 스마트폰 겨냥한 모바일용 3D NAND 솔루션 출시

32GB 3D NAND 메모리 기술, 차세대 모바일 멀티미디어와 스트리밍 경험 위해  
향상된 품질과 성능, 안정성 제공

미국 캘리포니아주 산타클라라. 2016년 8월 9일 (GLOBE NEWSWIRE / Korea Bizwire) - 마이크론(Micron Technology, Inc.) (나스닥 거래명: MU)이 자사 최초로 모바일 기기에 최적화된 3D NAND 메모리 기술과 UFS 2.1 표준에 기반한 제품을 선보인다. 마이크론의 모바일 3D NAND 기반 32GB 솔루션은 전세계 스마트폰 시장의 50% 가까이 차지하는\* 하이엔드와 미드엔드 세그먼트를 중점적으로 겨냥한 제품이다. 최근 모바일 기기가 PC를 넘어 사용자의 주력 컴퓨팅 기기로 자리잡으면서 기기 사용 행태에 따라 모바일 메모리와 스토리지 요구조건이 크게 영향을 받고 있다. 마이크론의 모바일 3D NAND 솔루션은 원활한 HD 동영상 스트리밍, 높아진 대역폭을 통한 게임 성능 향상, 부팅 속도와 카메라 성능, 파일 로딩 속도 향상 등 독보적인 사용자 경험을 제공함으로써 이 같은 우려에 대응한다.

\* 마이크론 자체 전망치

마이크론의 마이크 레이필드(Mike Rayfield) 모바일 사업부문 팀장은 “마이크론은 이번에 모바일용 3D NAND와 UFS 제품을 출시하면서 NAND 기술의 지속적 발전을 구현했다”면서 “3D NAND는 향상된 성능, 높은 용량과 증강된 안정성을 제공함으로써 고객들이 모바일 스토리지 수요 증가세에 대응하는 한편 보다 흥미진진한 사용자 경험을 제공할 수 있도록 지원할 것이다”고 밝혔다.

마이크론 3D NAND 기술은 데이터 스토리지 셀 레이어를 정밀하게 수직 적층해 기존의 Planar NAND 기술보다 3배 이상 용량이 늘어난 스토리지 솔루션을 구현했다. 이는 모바일 동영상 및 멀티미디어 소비에 따른 하드웨어 수요, 그리고 5G 무선 네트워크 도입으로 인해 증가할 것으로 전망되는 스토리지 수요에 대응하기 위한 것이다. NAND의 용량은 셀의 수직 적층으로 구현되기 때문에 마이크론은 기존 제품보다 더 작은 다이(die) 면적에 더 많은 스토리지 셀을 적층했다. 그 결과 메모리 다이가 업계에서 가장 크기가 작은(60.217mm<sup>2</sup>) 3D NAND를 출시할 수 있었다. 다이 면적이 작아질 경우 메모리 패키징 풋프린트를

최소화할 수 있다. 즉, 모바일 배터리나 더 작아진 폼팩터 기기에 맞는 공간을 추가로 확보하는 게 가능해진다.

그렉 웡(Greg Wong) 포워드 인사이트 창립자 겸 수석 애널리스트는 “3D NAND 기술은 스마트폰을 비롯한 모바일 기기의 지속적인 개발을 위해 필수적 요소가 될 것이다”면서 “5G 기술 발달과 더불어 사람들의 디지털화된 일상에 모바일이 미치는 영향력이 늘고 있는 상황에서 스마트폰 제조사들은 데이터 저장 및 관리를 위해 가장 첨단화된 기술을 필요로 하고 있다. 마이크론의 모바일용 3D NAND 솔루션은 사용자가 고해상도 동영상과 게임, 사진 촬영을 보다 원활하게 즐길 수 있도록 함으로써 증가세에 있는 시장의 스토리지 니즈에 대응하는 데 매우 적합하다”고 말했다.

### **3D NAND: 모바일 환경 변화를 주도하다**

마이크론이 처음으로 선보이는 모바일용 3D NAND 솔루션은 다양한 기술적 경쟁 우위를 가지고 있다. 주요 신기능은 다음과 같다:

- 플로팅 게이트 기술을 기반으로 하는 업계 최초의 모바일 제품이다. 플로팅 게이트 기술은 광범위하게 사용되는 설계로 수년에 걸친 planar 플래시 대량 생산을 통해 다듬어진 기술이다.
- 마이크론의 메모리 기기 가운데 최초로 UFS 2.1 표준에 부합한다. 이 표준은 모바일 시장을 대상으로 업계 최고 수준의 시퀀셜 리드(sequential read) 기능 구현이 가능하다.
- 3D NAND 기반의 멀티칩 패키지(MCP)는 저전력 LPDDR4X 을 탑재하고 있어 표준형 LPDDR4 메모리보다 최대 20% 더 높은 에너지 효율성을 구현한다.
- 업계에서 가장 작은(60.217mm<sup>2</sup>) 3D NAND 메모리 다이는 초소형 폼팩터 기기에 이상적인 형태로 메모리 패키징을 최소화할 수 있다. 마이크론의 3D NAND 다이 면적은 같은 용량의 planar NAND 다이보다 최대 30% 더 작다.

마이크론의 모바일용 3D NAND 솔루션은 현재 모바일 분야 고객사와 파트너사를 대상으로 샘플링을 시작했으며 2016 년 말에 본격 시판될 예정이다.

### **추가 자료:**

- 마이크론 모바일 메모리 솔루션: [www.micron.com/solutions/mobile-memory](http://www.micron.com/solutions/mobile-memory)

- 마이크론 3D NAND 제품: [www.micron.com/products/nand-flash/3d-nand](http://www.micron.com/products/nand-flash/3d-nand)
- 모바일용 3D NAND 데이터시트: [www.micron.com/products/nand-flash/3d-nand/mobile-3d-nand](http://www.micron.com/products/nand-flash/3d-nand/mobile-3d-nand)

마이크론의 다양한 소셜 네트워크 서비스를 통해 스토리지와 메모리 관련 정보를 얻을 수 있다:

- 블로그: [www.micron.com/about/blogs](http://www.micron.com/about/blogs)
- 트위터: [www.twitter.com/MicronTech](http://www.twitter.com/MicronTech)
- 링크드인: [www.linkedin.com/company/micron-technology](http://www.linkedin.com/company/micron-technology)
- 유튜브: [www.youtube.com/microntechnology](http://www.youtube.com/microntechnology)

### **마이크론(Micron Technology, Inc.) 소개**

마이크론은 첨단 반도체 시스템 분야의 글로벌 리더이다. DRAM, NAND, NOR 플래시 등 마이크론의 광범위한 고성능 메모리 기술 포트폴리오는 SSD, 모듈, MCP, 기타 시스템 솔루션의 밑바탕이 되고 있다. 35년에 걸친 기술 리더십을 기반으로 하는 마이크론의 메모리 솔루션은 전세계에서 가장 혁신적인 컴퓨팅, 가전제품, 기업용 스토리지, 네트워킹, 모바일, 임베디드 및 자동화 애플리케이션을 구동하는 데 쓰인다. 마이크론의 보통주는 나스닥에서 MU 라는 거래명으로 거래되고 있다. 자세한 정보는 [www.micron.com](http://www.micron.com) 에서 확인할 수 있다.

언론 연락처

새라 루이스(Sarah Lewis)

Zeno Group for Micron Technology

650-801-0937

[sarah.lewis@zenogroup.com](mailto:sarah.lewis@zenogroup.com)